

Проблемы начались еще в конце 2024 года, когда NVIDIA должна была запустить массовое производство серверов Blackwell. Сообщалось, что новая архитектура имела конструктивный дефект, из-за которого наблюдались повышенные тепловые нагрузки. Несмотря на заверения компании о решении проблемы, свежий отчет от The Information указывает на то, что серверы по-прежнему испытывают сбои, связанные с неправильным соединением чипов.

Ключевой проблемой, по данным экспертов, является технология упаковки CoWoS от TSMC, используемая для соединения компонентов. NVIDIA попыталась внести изменения в производство, заменив маску GPU, но это не принесло желаемого результата. На фоне этих сложностей крупные заказчики начали переключаться на предыдущую, проверенную временем линейку Hopper.